



2021年12月期第1四半期 決算説明資料

株式会社RS Technologies

2021年5月14日



東証1部
3445

目次

会社概要

P.3

会社概要
沿革
DGテクノロジーズ 新工場立ち上げ
山東GRITEK 新工場竣工
現在のRS Technologies
ウェーハ再生事業の地域別出荷数構成比

2021年12月期第1四半期 決算概要

P.10

特別損失(株式報酬費用)計上について
決算概要
セグメント及び会社別動向
セグメント動向 四半期業績グラフ
会社別動向 四半期業績グラフ
貸借対照表

中期経営計画（21年～24年）

P.17

中期経営計画（4か年）の概要
2021年12月期 決算見通し
設備投資計画：ウェーハ再生事業
設備投資計画：プライムウェーハ事業
中国投資計画（スケジュール）
ウェーハ再生事業の新規需要
再生ウェーハの需要見通し
第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略
RS Technologiesの目指す世界

Appendix1 中国子会社上場準備

P.29

中国子会社の上場準備開始について
中国子会社の上場準備の進捗状況

Appendix2

P.33

代表取締役 方永義の強み
ウェーハ再生ビジネス(1) (2)
プライムウェーハビジネスへの進出
中国における当社合併相手について
山東省徳州市と提携：背景、経緯及び現状
中国事業への出資スキーム
業績推移・主要財務諸表・セグメント別業績推移

1. 会社概要

会社概要

- ウェーハ再生で世界市場シェア3割の**トップ企業**※1。
- 中国中央政府直属企業との合併事業で**プライムウェーハ事業**にも本格進出。
- M&Aによりシナジーの期待できる**周辺事業領域**にも事業を拡大。

社名	株式会社RS Technologies
設立	2010年12月10日
経営理念	「地球環境を大切に、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」
事業内容	電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。太陽光発電事業。半導体関連設備の買取及び販売事業。半導体材料・パーツの販売。半導体シリコンウェーハ製造の技術コンサルティング。
本社所在地	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
資本金	5,438百万円（2021年3月末時点）
代表取締役	方 永義
主な連結子会社	艾爾斯半導体股份有限公司（台湾）資本金 NT \$300 million 出資比率 100%
	北京有研RS半導体科技有限公司（北京）登録資本 US \$138 million 出資比率 45% ※2
	有研半導体材料有限公司（北京）登録資本 8億人民元 出資比率 42.7% ※2
	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューション 資本金 27百万円 出資比率 100%
	山東有研半導体材料有限公司（山東省徳州市）登録資本 15億人民元 出資比率 34.2% ※2
	株式会社DG Technologies 資本金 100百万円 出資比率 100%

※1 SEMIデータに基づき弊社にて推計。

※2 中国事業における、連結対象となる出資スキームは、北京有研RS半導体科技有限公司を親会社として、有研半導体材料有限公司を子会社、山東有研半導体材料有限公司を孫会社としており、出資が一部重複しております。詳細は、P40「中国事業への出資スキーム（2020年11月開示内容実施後）」をご参照ください。

沿革

- ウェーハ再生事業で世界トップ。中国の大手プライムウェーハメーカーを連結子会社化、ウェーハ総合メーカーに。
- 2020年10月、山東省徳州市において、山東GRITEKの新工場が竣工、生産開始。

2010年（平成22年）12月	ウェーハ再生事業を主たる事業として株式会社RS Technologiesを設立
2011年（平成23年）1月	三本木工場において操業開始
2011年（平成23年）11月	三本木工場がUKASより「ISO9001:2008」（品質マネジメントシステム）認証取得
2013年（平成25年）10月	三本木工場においてソーラー事業を開始
2014年（平成26年）2月	台湾に子会社として艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）を設立
2015年（平成27年）3月	東京証券取引所マザーズに株式を上場
2015年（平成27年）6月	最先端設備（18インチウェーハ再生可能）を導入した三本木工場・第8工場が竣工
2015年（平成27年）12月	艾爾斯半導體股份有限公司（現・連結子会社）の台南工場が竣工
2016年（平成28年）9月	東京証券取引所市場第一部（東証一部）へ市場変更
2017年（平成29年）12月	有研科技集团有限公司（GRINM）及び福建倉元投資有限公司と三社間で合併契約を締結
2018年（平成30年）1月	北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）を設立、中国プライムウェーハ製造メーカーである有研半導体材料有限公司（GRITEK）を連結子会社化
2018年（平成30年）5月	株式会社ユニオンエレクトロニクスソリューションの100%株式を取得(日立パワーデバイスの特約店)
2018年（平成30年）8月	山東有研半導体材料有限公司(GRITEKの連結子会社、山東GRITEK)を設立
2019年（平成31年）1月	株式会社DG Technologies（DG）の100%株式を取得
2019年（令和元年）12月	GRINM、徳州滙達半導体股權投資基金パートナー企業及び山東省徳州市政府と四者間で合併契約を締結
2020年（令和2年）2月	上海悠年半导体有限公司（上海ユニオン）を設立
2020年（令和2年）3月	山東有研RS半導体材料有限公司（SGRS）並びに有研艾唯特（北京）科技有限公司（北京IVT）を設立
2020年（令和2年）10月	中国におけるプライムウェーハの生産拠点となる、山東GRITEKの新工場が竣工、生産開始
2021年（令和3年）5月	DGの第2の生産拠点として、栗原工場（宮城県栗原市）を立ち上げ

DGテクノロジーズ 新工場立ち上げ

- 神栖工場がフル稼働のため、拡大する顧客需要に対応すべく、2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ。
- 従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場（新設）の2拠点体制で、増加する受注に対応。

神栖工場



工場名	DG Technologies 神栖工場
所在地	茨城県神栖市
建物面積	5,378㎡

栗原工場



シリコン電極



石英リング

工場名	DG Technologies 栗原工場
所在地	宮城県栗原市
建物面積	5,000㎡

山東GRITEK 新工場竣工

- 2020年10月、山東省徳州市において、山東GRITEKの新工場が竣工。
- 中国におけるプライムウェーハの製造拠点として稼働開始。

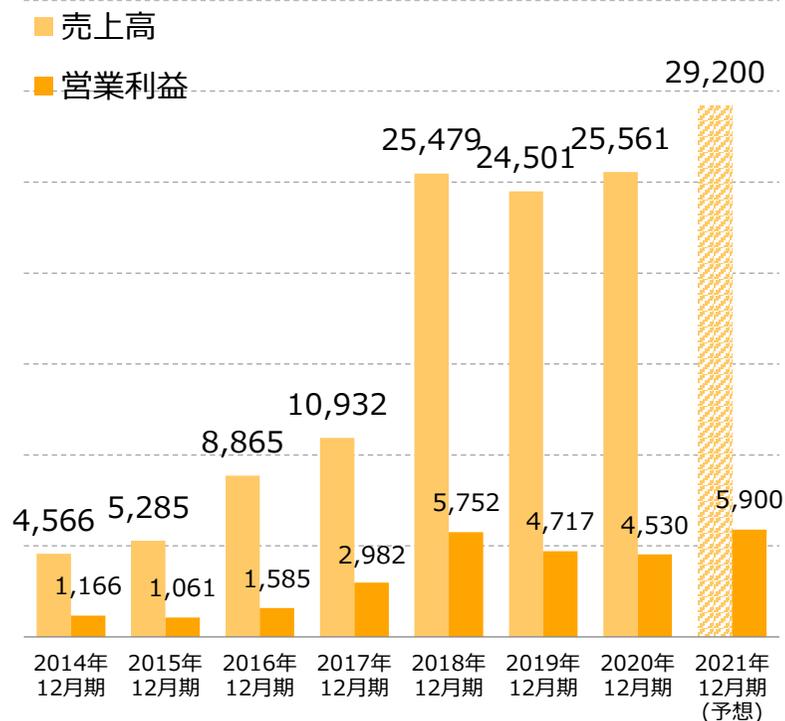


現在のRS Technologies

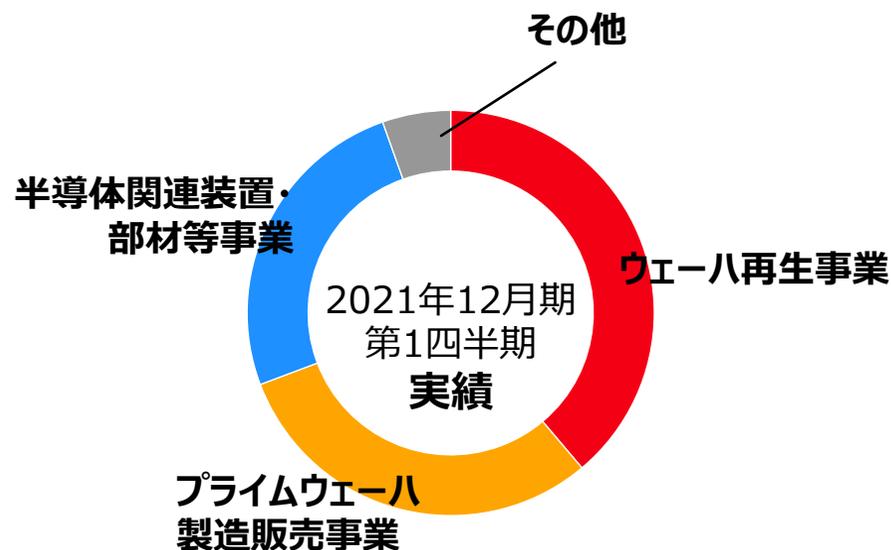
- ウェーハ再生事業 + プライムウェーハ事業の総合ウェーハメーカー。
- 半導体関連装置・部材等事業及びソーラー事業へも事業領域を拡大。
- ウェーハ再生事業はグローバルシェアNo1、プライムウェーハ事業では中国国内向けを中心に事業を展開。

連結売上高および営業利益

(百万円)

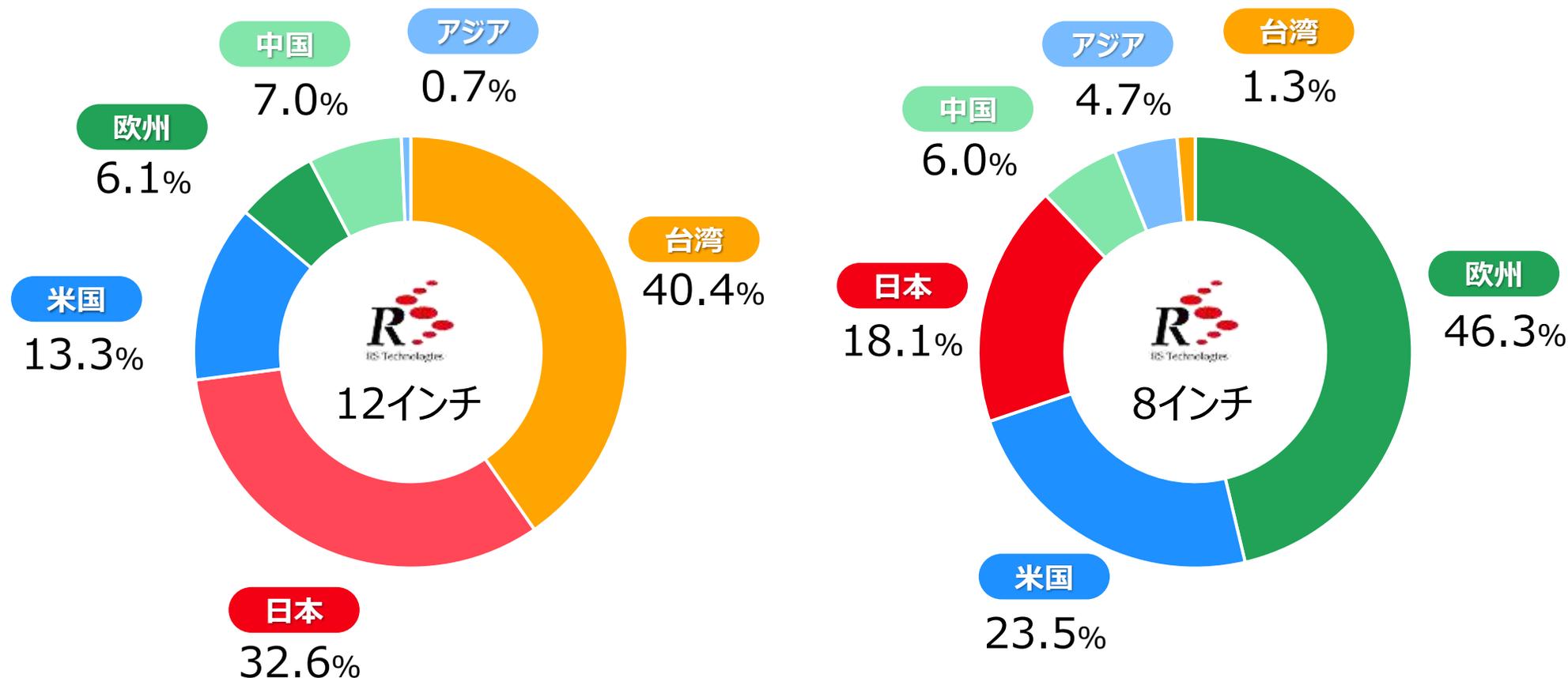


セグメント別売上高



ウェーハ再生事業の地域別出荷数構成比

- 日本、台湾、欧米を中心に、世界の主要な半導体メーカーを顧客としている。
- 2020年10月、山東GRITEKの新工場が竣工、今後の需要拡大に対応。



注：RST調べ、枚数ベース(2020年度)

2. 2021年12月期第1四半期 決算概要

特別損失（株式報酬費用）計上について

■経緯

- ・2020年11月19日付「（開示事項の経過）当社海外子会社の上場準備に伴う株式一部譲渡のお知らせ」にて開示致しました、当社の連結子会社である北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）の有する有研半導体材料有限公司（GRITEK）株式をGRITEK 社員持株会へ2021年2月に譲渡。

<当社の認識>

- ・GRITEKの企業価値を、第三者評価機関（中国証券監督管理委員会指定の専門資産評価機構）に算定を依頼し、当該機関が算定した企業価値（時価純資産）を公正価値とし従業員持株会に譲渡。

<監査法人の認識>

- ・機関投資家の見積価格（見積上限価格：2021年4月受領）が公正価値。

■結果・影響

- ・譲渡価格と監査法人の認識した公正価値の差額を特別損失（1,348百万円）計上。
- ・本件による、キャッシュアウトは無し。
- ・本件による、純資産への影響は無し。
特別損失計上により、利益剰余金が減少するが、資本剰余金が増加するため、純資産への影響は無し

2021年12月期第1四半期 決算概況

- 売上高は、ウェーハ再生事業及び半導体関連装置・部材等事業の寄与により、前年同期比増収。
- 営業利益は、プライムウェーハ事業における新工場立ち上げ費用等により、前年同期比減益。
- 親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比減益（詳細は前ページを参照）。

(百万円)	2020年12月期 第1四半期	2021年12月期 第1四半期	前期比	前期比 増減率	2021年12月期 第2四半期累計 予算 進捗率	2021年12月期 第2四半期累計 予算
売上高	6,182	6,684	502	8.1%	51.0%	13,100
営業利益	1,173	755	▲418	▲35.6%	34.3%	2,200
営業利益率	19.0%	11.3%	▲7.7Pt			16.8%
経常利益	1,408	1,191	▲217	▲15.4%	54.1%	2,200
経常利益率	22.8%	17.8%	▲5.0Pt			16.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	826	▲540	▲1,366	▲165.4%	▲41.5%	1,300
一株当たり 当期純利益	64.43円	▲41.83円	▲106.26円	▲164.9%		100.86円

2021年12月期第1四半期 セグメント及び会社別動向

- ウェーハ再生事業は、旺盛な顧客需要により、前期比増収増益。
- プライムウェーハ事業は、新工場立ち上げの進展により前期比微増。営業利益は、新工場立ち上げ費用等※により、前期比減益。
- 半導体関連装置・部材等事業は、営業体制強化等による販売増加で前期比増収。営業利益は、製品ミックスの影響等により前期比減益。

※新工場立ち上げ費用に対して中国政府より補助金を受領し営業外収益に計上しています。

セグメント別 (百万円)	ウェーハ再生事業		プライムウェーハ 製造販売事業		半導体関連装置・ 部材等事業		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	2,913	6.3%	2,280	1.0%	1,898	38.6%	▲407	-	6,684	8.1%
営業利益	1,064	7.2%	▲211	▲170.6%	81	▲28.3%	▲179	-	755	▲35.6%
営業利益率	36.5	0.3pt	▲9.3	▲22.5pt	4.3	▲4.0pt	-	-	11.3	▲7.7Pt

会社別 (百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他、調整額		連結合計	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
売上高	3,091	22.9%	1,288	13.5%	2,204	▲2.3%	101	-	6,684	8.1%
営業利益	586	24.9%	392	4.3%	▲238	▲173.5%	15	-	755	▲35.6%
営業利益率	19.0	0.3pt	30.4	▲2.7pt	▲10.8	▲25.2Pt	-	-	11.3	▲7.7Pt

2021年12月期第1四半期 セグメント動向 四半期実績グラフ

- ウェーハ再生事業は、顧客の強い需要を背景に、引き続き堅調な推移。
- プライムウェーハ事業は、新工場立ち上げの進展により、前四半期比増収。営業利益は、新工場立ち上げ費用等※により前四半期比赤字幅縮小。
- 半導体関連装置・部材等事業は、営業体制強化等による販売増加、及び、半導体製造関連消耗部材の好調により、売上高は堅調な推移。

※新工場立ち上げ費用に対して中国政府より補助金を受領し営業外収益に計上しています。

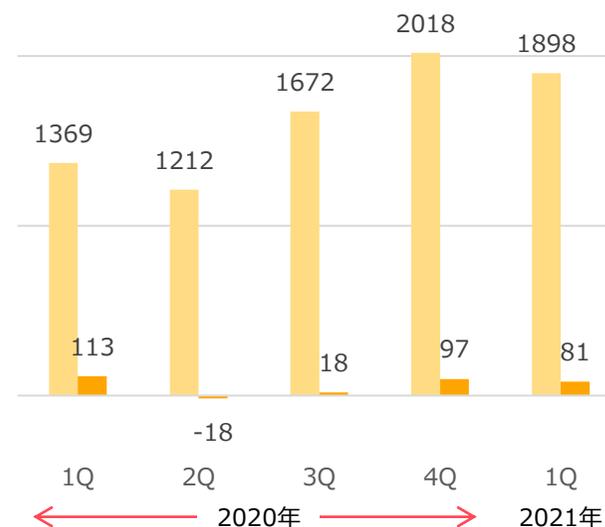
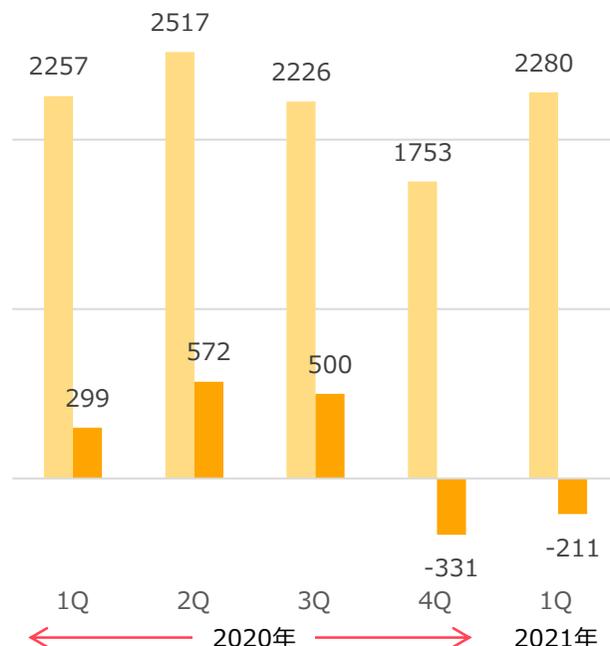
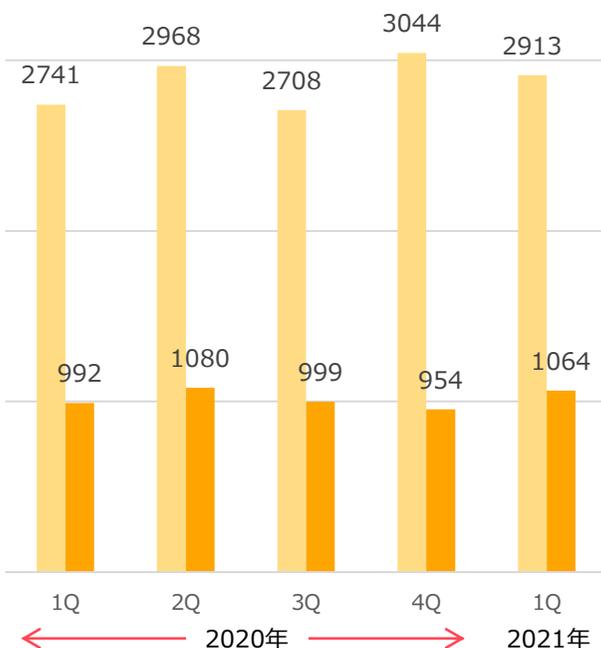
ウェーハ再生事業

プライムウェーハ事業

半導体関連装置・部材等

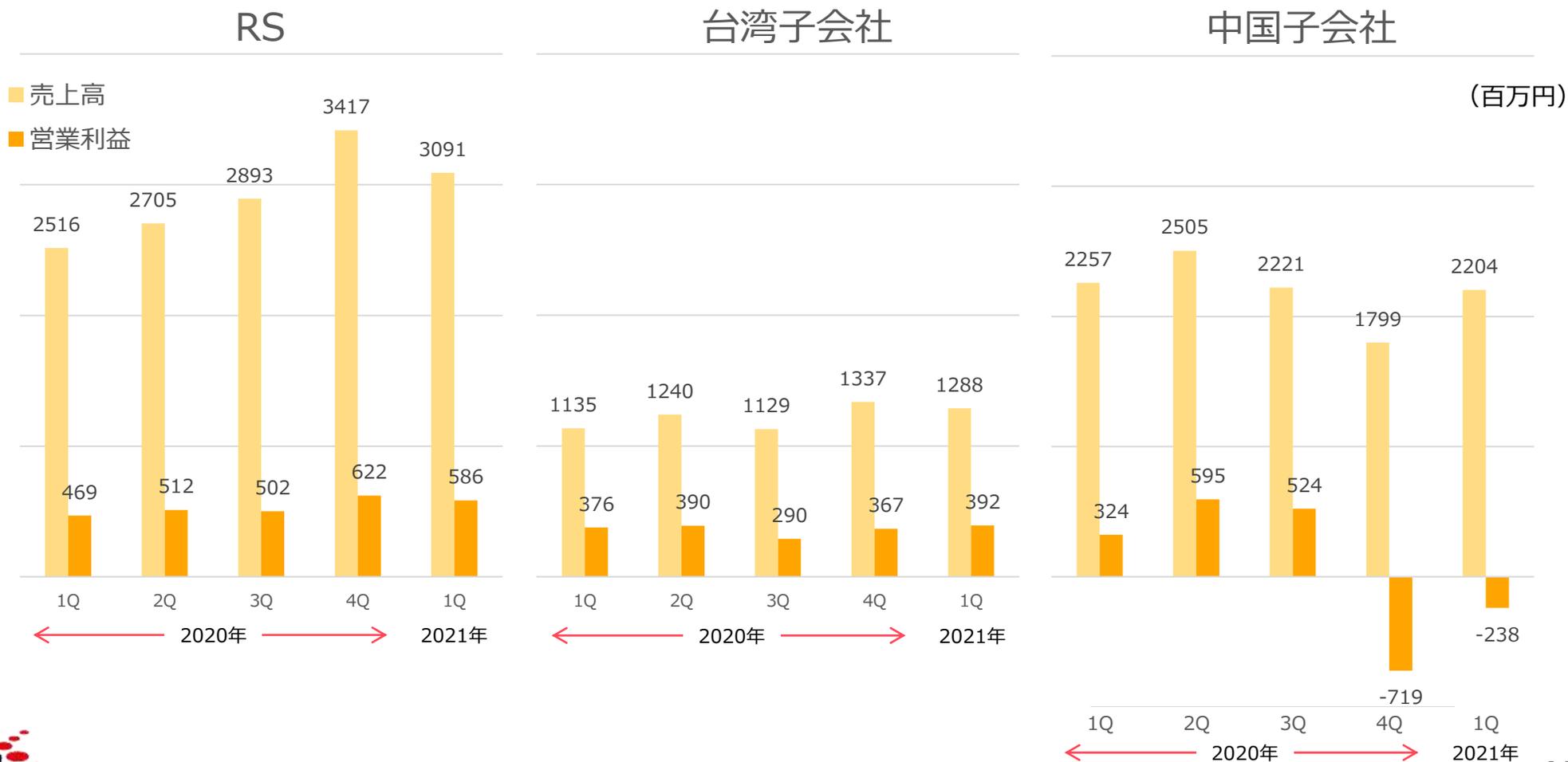
■ 売上高
■ 営業利益

(百万円)



2021年12月期第1四半期 会社別動向 四半期実績グラフ

- RSは、ウェーハ再生事業、及び、半導体関連装置・部材等事業が堅調に推移。
- 台湾子会社は、引き続き顧客需要が強く、堅調な推移。
- プライムウェーハ事業は、新工場立ち上げの進展により、前四半期比増収。営業利益は、新工場立ち上げ費用等※により前四半期比赤字幅縮小。
※新工場立ち上げ費用に対して中国政府より補助金を受領し営業外収益に計上しています。



貸借対照表

- 山東有研RS半導体材料有限公司（SGRS）への追加出資実施により投資その他資産が増加。

連結貸借対照表

(百万円)	2020年12月期	2020年12月期 第1四半期
資産の部		
流動資産	32,626	35,280
現金及び預金	19,082	20,627
受取手形及び売掛金	6,321	6,837
商品及び製品	2,116	1,961
固定資産	26,124	30,155
有形固定資産	24,146	26,064
無形固定資産	527	507
投資その他資産	1,451	3,584
資産合計	58,750	65,435
負債の部		
流動負債	12,631	13,790
支払手形及び買掛金	2,871	3,355
有利子負債	1,522	2,770
固定負債	5,754	8,955
長期借入金	1,613	2,906
負債合計	18,385	22,746
純資産	40,365	42,689
負債・純資産合計	58,750	65,435

3. 中期経営計画

中期経営計画（4か年）の概要

- ウェーハ再生事業は、需要の拡大を想定した投資を実施し、堅調な推移を想定。
- 8インチプライムウェーハ事業は、安定生産期へ移行し、増産が寄与。
- 半導体関連装置・部材等事業は、中国での新市場開拓やグループシナジーの活用による成長戦略を実施。

	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	2023年 12月期	2024年 12月期
	実績	計画	計画	計画	計画
売上高	25,561	29,200	32,900	34,800	37,100
営業利益	4,530	5,900	6,500	7,000	7,900
営業利益率	17.7%	20.2%	19.8%	20.1%	21.3%
経常利益	5,252	5,900	6,600	7,100	8,000
経常利益率	20.5%	20.2%	20.1%	20.4%	21.6%
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,824	3,100	3,700	4,200	4,800
一株当たり 当期純利益	219.15	240.51	286.19	324.87	371.27

2021年12月期 決算見通し

- RS及び台湾子会社は、設備投資による減価償却費の増加等により前期比減益を見込むものの、プライムウェーハ事業における新工場の生産拡大や、半導体関連装置・部材等事業の更なる売上増加により、連結では前期比増収増益を想定。

(百万円)	2020年12月期 (2020年1月～12月)	2021年12月期 (2021年1月～12月)	前期比	
	通期実績	通期予想	増減	増減率
売上高	25,561	29,200	3,639	14.2%
営業利益	4,530	5,900	1,370	30.2%
営業利益率	17.7%	20.2%	2.5pt	
経常利益	5,252	5,900	648	12.3%
経常利益率	20.5%	20.2%	△0.3pt	
親会社株主に帰属する当期純利益	2,824	3,100	276	9.8%
一株当たり当期純利益	219.15円	240.51円	21.36	9.7%
年間配当金	20円	20円	-	-

(百万円)	RS		台湾子会社		中国子会社		その他、調整額	連結合計	
		前期比		前期比		前期比			前期比
売上高	11,300	△2.0%	4,900	1.2%	10,900	8.4%	2,100	29,200	14.2%
営業利益	1,700	△19.3%	1,200	△15.8%	2,600	66.2%	400	5,900	30.2%
営業利益率	15.0%	△3.3pt	24.5%	△4.9pt	23.9%	8.4pt	-	20.2%	2.5pt

設備投資計画：ウェーハ再生事業

■世界の半導体需要が拡大する中、日本・台湾での増産、及び、中国山東省において量産開始。

日本

総投資額： 14億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充
- 2021～2022年：14億円(4万枚)

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2020年	2021年	2022年	2023年
26万枚	28万枚	30万枚	30万枚

2021年度	2022年度	2023年度
9億円	5億円	未定

台湾

総投資額： 14億円

- 12インチ再生ウェーハの生産能力拡充及び微細化対応
- 2021～2023年：14億円(4万枚)

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2020年	2021年	2022年	2023年
16万枚	18万枚	19万枚	20万枚

2021年度	2022年度	2023年度
8億円	3億円	3億円

中国

総投資額： 36億円

- 12インチ再生ウェーハ生産拠点の新設投資
- 第1期投資(2021～2023年)：36億円(5万枚)
- 第2期投資(2024年～)：投資額未定（5万枚）

12インチ再生ウェーハ生産能力（月産）

2020年	2021年	2022年	2023年
0万枚	0万枚	5万枚	5万枚

第1期投資

2021年度	2022年度	2023年度
30億円	5億円	1億円

設備投資計画：プライムウェーハ事業

- 8インチプライムウェーハは、新工場の早期立ち上げを実施し、月産13万枚での安定した量産体制の構築を目指す。
- 12インチプライムウェーハは、月産1万枚のテストラインを設置し、量産化研究開発を進める。

中国 8インチ

- 新工場の早期立ち上げ
- 安定した量産体制の構築を目指す

8インチプライムウェーハ生産能力（月産）

2020年 → 2021年
8万枚 → **13**万枚

2021年度	2022年度	2023年度
—※1	未定	未定

※1 2020年度までに投資済み

中国 12インチ

テストライン投資額： 40億円

- 12インチプライムウェーハ量産化のための研究開発
- 1万枚のテストラインを経て、30万枚の量産体制を目指す

12インチプライムウェーハ生産能力（月産）

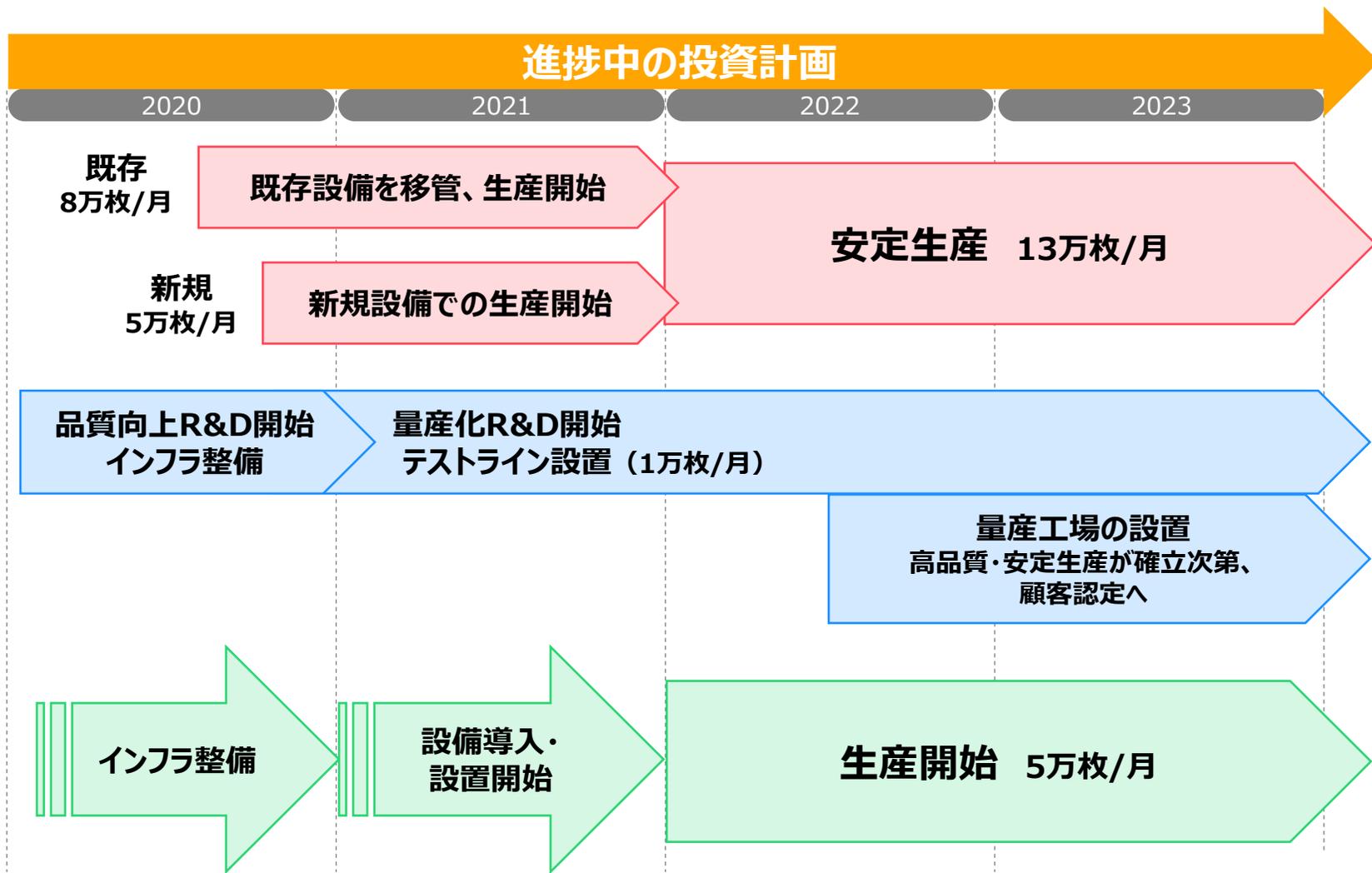
2020年 → 2021年 → 202X年
0万枚 → **1**万枚※2 → **30**万枚

2021年度	2022年度	2023年度
40億円	未定	未定

※2 量産化研究開発のためのテストライン

中国投資計画（スケジュール）

- 8インチ月産13万枚の安定生産、及び、12インチの月産1万枚のテストラインの設置による量産化研究開発、ウェーハ再生事業の立上げを並行して実施。12インチは高品質化・安定生産を早期に目指す。



ウェーハ再生事業の新規需要：12インチ半導体新工場

- 中欧米日等でメモリー・CPU・自動車の電子化等による旺盛な半導体需要に対応した、12インチ半導体新工場が建設中。
- 日本、台湾及び中国への設備投資により、新たな再生ウェーハ需要へ対応。

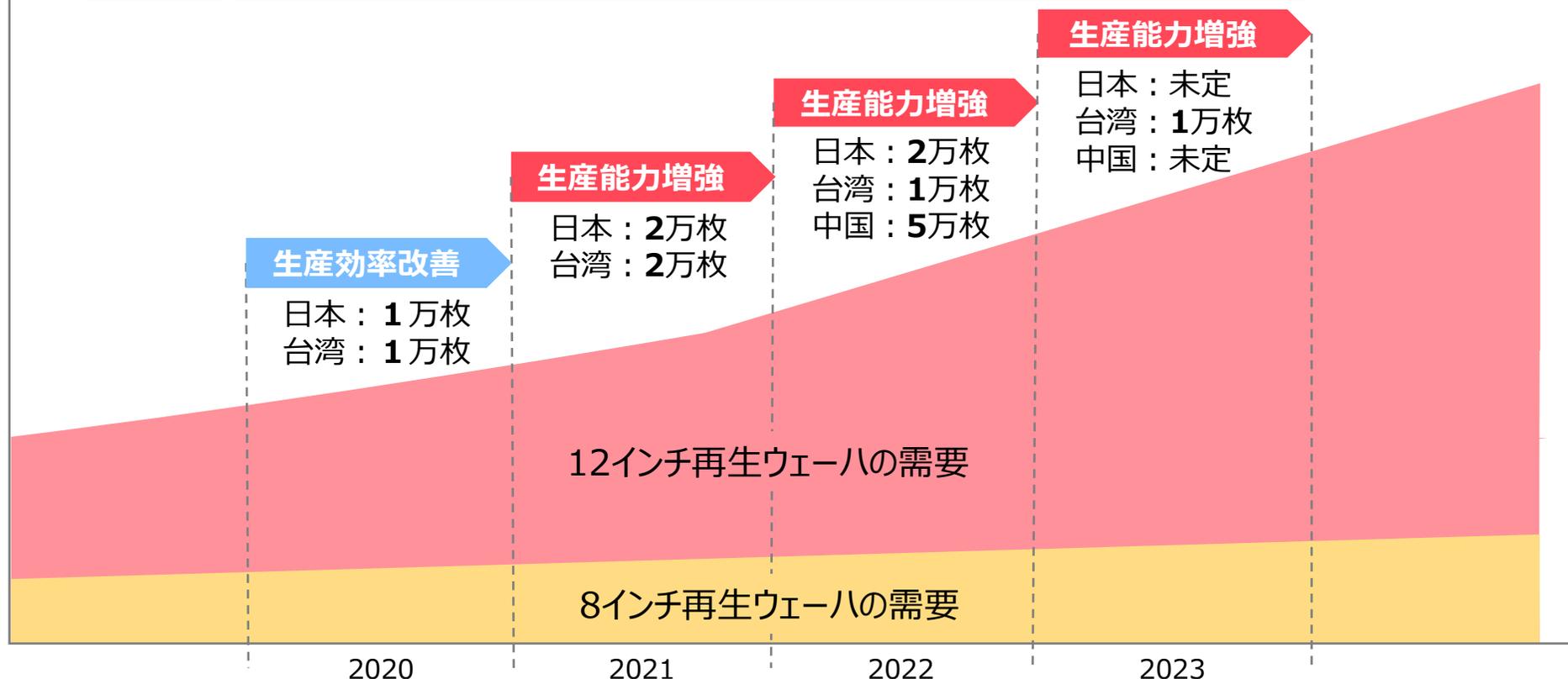


注：RST調べ

再生ウェーハ需要の見通し：12インチ中心に拡大続く

- 拡大する12インチの再生ウェーハ需要に対応し、2021～2023年に日本で4万枚、台湾で4万枚、中国で5万枚の生産能力増強を予定。

生産能力	2020年末	2021年末	2022年末	2023年末
日本	26万枚	28万枚	30万枚	30万枚
台湾	16万枚	18万枚	19万枚	20万枚
中国	0万枚	0万枚	5万枚	5万枚
計	42万枚	46万枚	54万枚	55万枚



注：RST調べ

第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（1/3）

- DGテクノロジーズは、大手半導体製造メーカーや半導体設備メーカーへ消耗部材を製造販売する部材メーカー。
- 2019年1月に、当社連結子会社化。

会社概要

DGtec 株式会社DGテクノロジーズ

社名	株式会社DG Technologies
設立	1981年10月26日
事業内容	半導体製造装置向けの消耗部材の製造・販売
所在地	茨城県神栖市砂山3-4
資本金	100,000千円
代表取締役	方 永義

製品

ドライエッチング装置向け
石英・シリコン製消耗部材



シリコン電極



石英リング

主な顧客

半導体製造メーカー
半導体設備メーカー 等

第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（2/3）

- ドライエッチング装置向け部材市場は推定1500億円*1で今後も成長が見込まれる。
- RS既存ウェーハ顧客への営業とGRITEK仕入によるシナジー、及び、生産能力拡大と生産効率化による成長戦略を策定・実施。同市場におけるトップシェアを狙う。

市場の成長性

ドライエッチング装置向け
石英&シリコン消耗部材市場



約1,500億円
*1

ドライエッチング装置市場と
同程度の成長を期待

(先行指標)

ドライエッチング
装置市場



成長率
8% *2

成長戦略

- ◆ 営業活動の強化
RS既存ウェーハ顧客へのクロスセルを実施
- ◆ 生産能力の増強
設備投資を実施し、顧客の要求数量をタイムリーに生産・出荷する体制を構築
- ◆ 生産効率の向上
生産能力増強と合わせて、人員・生産工程等の最適化を行い生産効率向上を図る
- ◆ 仕入の最適化
当社グループ会社のGRITEKより原材料仕入を行うことで、競争力強化を図る

第3の成長エンジン：DGテクノロジーズの成長戦略（3/3）

- 神栖工場がフル稼働のため、拡大する顧客需要に対応すべく、2021年5月、宮城県に栗原工場を立ち上げ。
- 従来からの生産拠点である神栖工場と栗原工場（新設）の2拠点体制で、増加する受注に対応。

神栖工場



工場名	DG Technologies 神栖工場
所在地	茨城県神栖市
建物面積	5,378㎡

栗原工場



シリコン電極

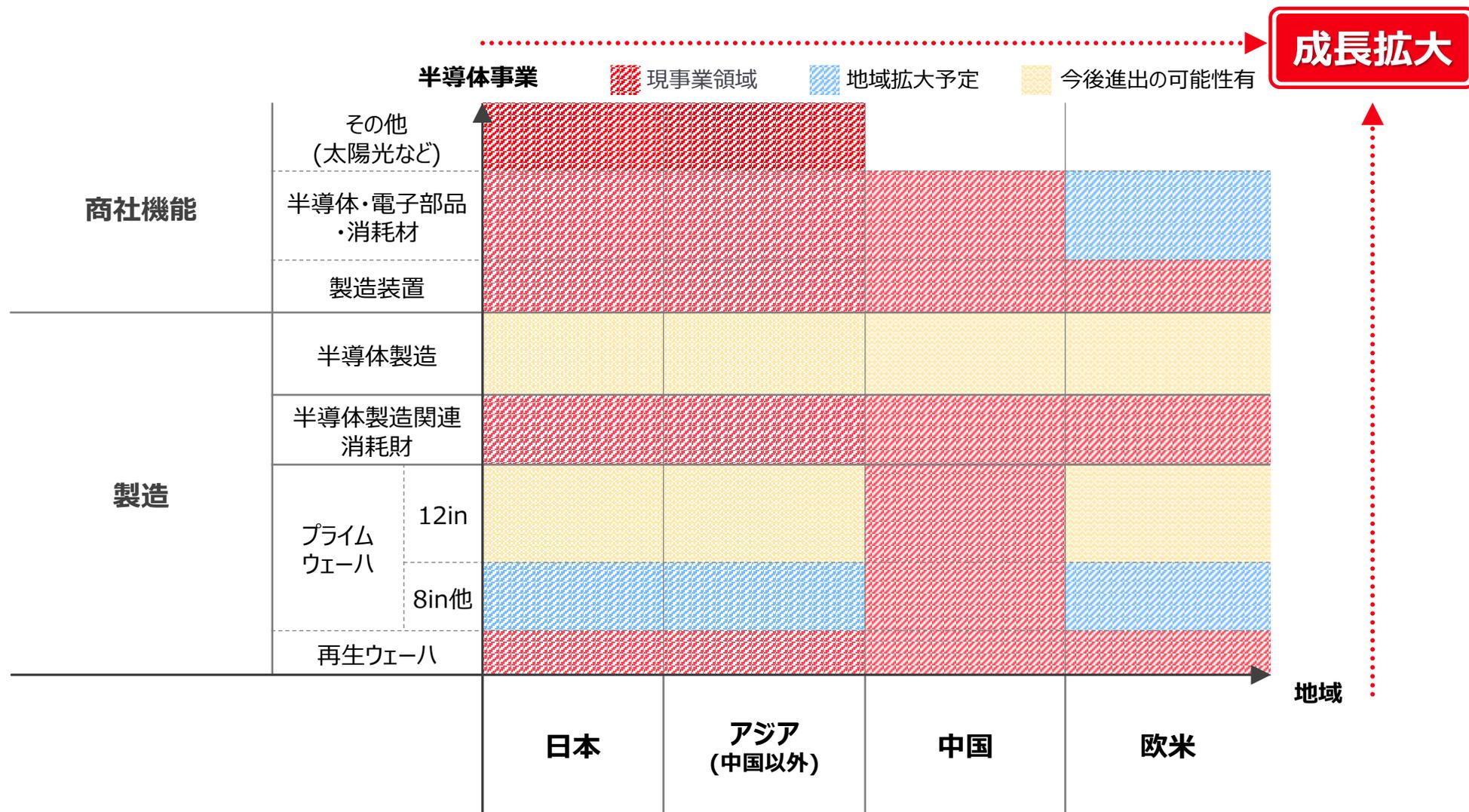


石英リング

工場名	DG Technologies 栗原工場
所在地	宮城県栗原市
建物面積	5,000㎡

RS Technologiesの目指す世界

- 一步一步、着実に事業領域および販売地域を広げていく。



Appendix1

中国子会社GRITEK上場準備：これまでの流れ

中国子会社（GRITEK） 上場準備を開始（2020年9月開示）

- 2020年9月、中国子会社（GRITEK）の上場準備を開始。
- 上場により、事業基盤を確立することで、更なる成長性を確保し、当社グループの企業価値の向上を図る。

上場の目的

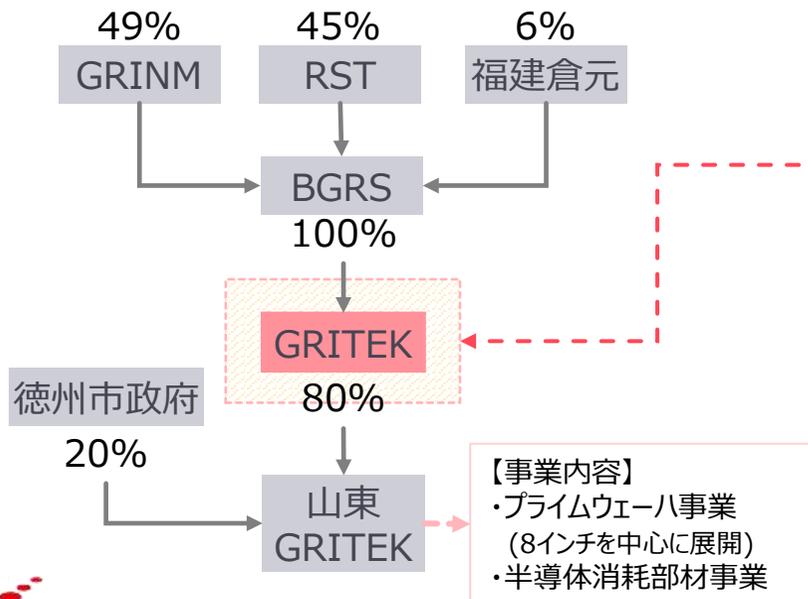
中国における事業基盤の確立

- ・資金調達手段の多様化
- ・ブランド力の向上
- ・優秀な人材の獲得

成長性の確保

- ・成長資金の確保
- ・営業力強化
- ・研究開発の促進及び生産性向上

当社グループの
企業価値向上



上場主体：GRITEK

- ・1999年設立、プライムウェーハの製造販売を営む
- ・2018年に当社グループの連結子会社化
- ・2020年の工場移転により、山東GRITEKへプライムウェーハの生産拠点を集約

上場予定市場：科创板市場（スターマーケット）

- ・中国版ナスダックと呼ばれる上海証券取引所の新興企業向け株式市場
- ・中国政府主導で開設され、2019年7月22日に取引開始
- ・他市場に比べ、収益性などの上場基準が緩和され、審査手続きも簡略化
- ・銘柄は新興ハイテク企業が中心
- ・当初 25 銘柄が上場し、1年間で 130 社超に拡大

中国子会社（GRITEK） 上場準備の進捗状況（2020年11月開示）

- 中国子会社（GRITEK） 上場準備の一環として、BGRSが保有するGRITEK株式の一部譲渡を、2020年11月19日開催の取締役会において決議。

株式譲渡の概要

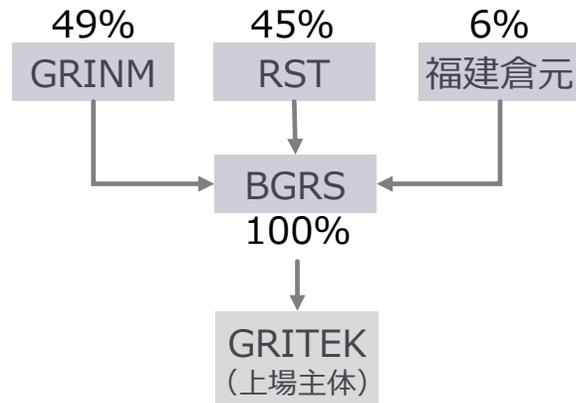
- ・譲渡前：BGRSは、GRITEK株式の100%を保有。
- ・譲渡内容：BGRSが保有するGRITEK株式を、GRINMへ25.60%、福建倉元へ3.14%、社員持株会へ5.00%、及び当社へ23.51%を譲渡。

株式譲渡の目的

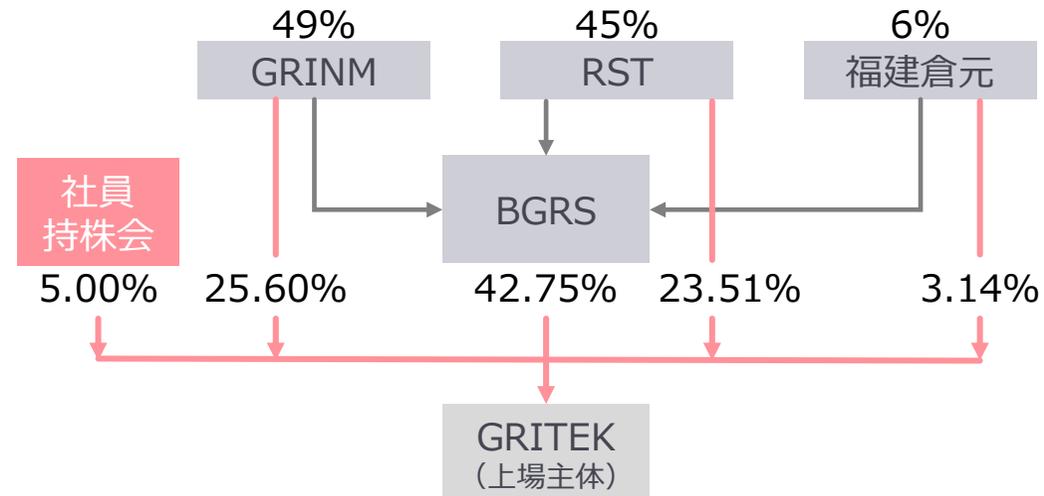
- ・従業員のモチベーションや帰属意識の向上
- ・中国国有機関であるGRINMとの良好な関係性の維持

↓
当社グループの企業価値向上

株式譲渡前



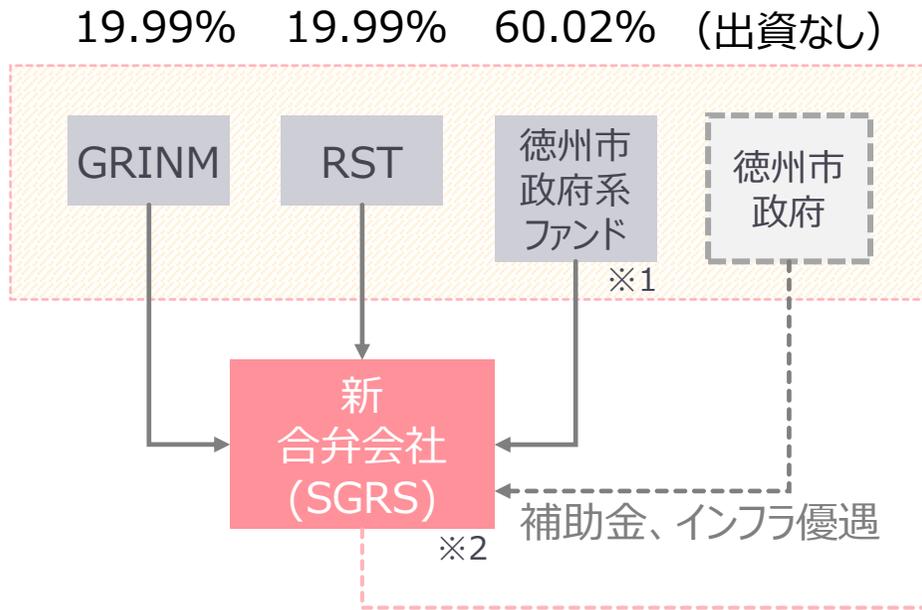
株式譲渡後



中国における12インチシリコンウェーハ事業スキーム

- 徳州市政府等と共同で新たな合併会社を2020年3月に設立。
- 12インチシリコンウェーハ事業へ参入も、当初の出資比率を押さえることで初期リスクを抑制。
- 1万枚/月のテストラインを経て、30万枚/月の量産体制を目指す。

合併会社の出資スキーム



合併契約

- ・合併契約は4者間で締結。
- ・出資は3者（GRINM、RST、徳州政府ファンド）
- ・徳州市政府はインフラ等のサポートを提供。

事業内容

- ・12インチプライムウェーハ事業(生産、販売、開発)
- ・12インチウェーハ再生事業

※1 徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業

※2 山東有研RS半導体材料有限公司

Appendix2

代表取締役 方永義の強み

- 代表取締役社長である方永義が20年以上にわたって日本で培った知見と自身が持つネットワークを生かした全世界への販売力・人脈力・提携力・資金力が強み。
- 方永義の下にハイテクや金融など幅広い分野のプロフェッショナル人財が集結。



方永義は 前列中央（2016年9月、東京証券取引所にて撮影）

方 永義（ほう ながよし）

1970年生まれ 中国福建省出身
城西国際大学院 修了

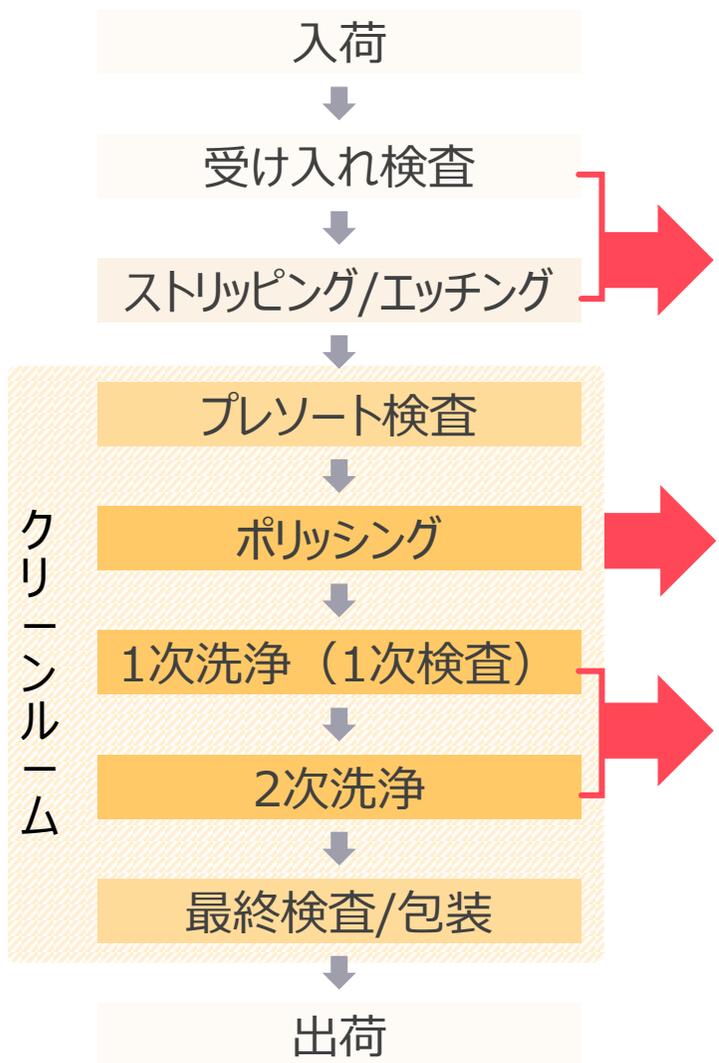
得意分野：
M & A、業務提携（過去10社を超えるM & Aを成功）

1998年 永輝商事設立
2010年 当社設立社長就任（現任）

大切にしている心：為せば成る

補足：

高校卒業後に来日。日本国内外で20以上の会社の投資経験。「半導体事業」の他、ファンドや貿易、ホテル、IT事業、農業等様々な業界の投資を経験。「日本のものづくりは世界一」との信条の元、それを世界に広めていくため、世界中を飛び回っている。



強み 1

すべての膜を剥離可能

- ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に

▶ 再生回数が多い ▶ よりコストダウンが可能

ラサ工業（化学）の特異技術を継承



表面に付いているキズや凹凸を研磨（ポリッシング）により平滑にする

強み 2

金属不純物を除去

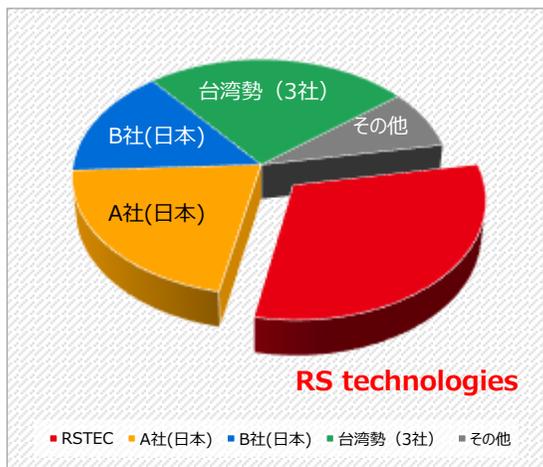
- ウェーハ表面の微細ゴミ・汚れを洗浄で取り除く
- + 金属不純物を除去 特に銅 (Cu) の除染除去に強み



再生ウェーハビジネス(2)

再生市場での当社のシェア拡大

12インチ再生市場における当社シェア



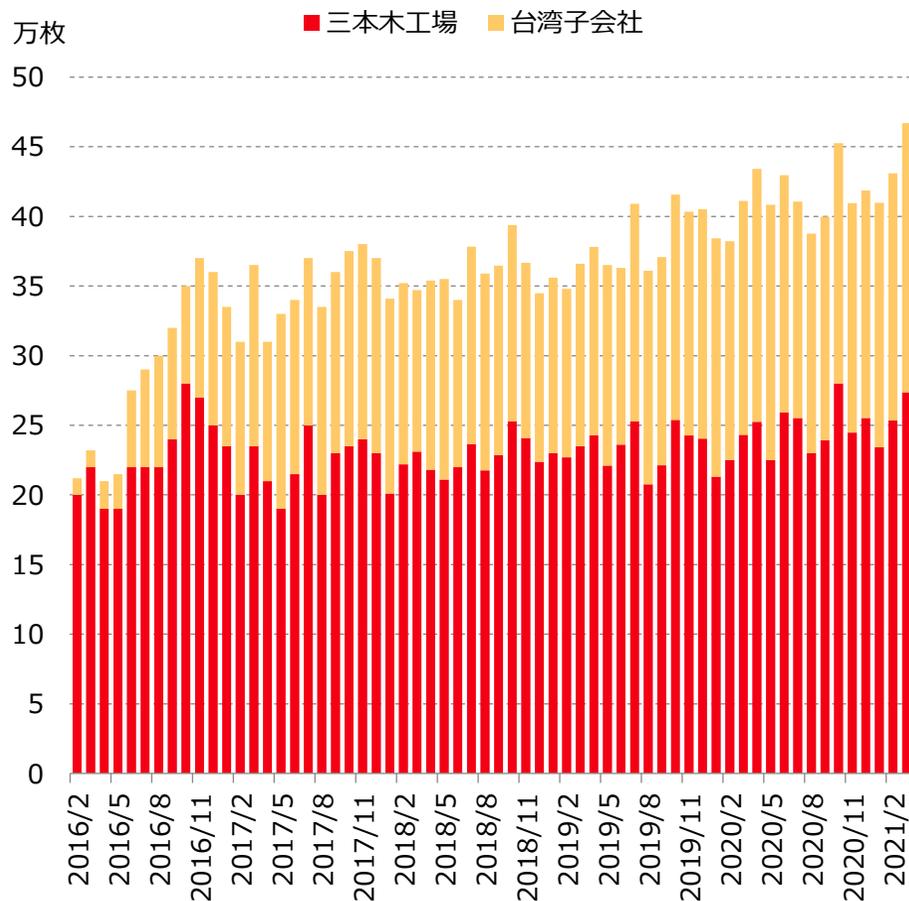
注：RST調べ

	2015 年上期	2015 年下期	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
当社グループ 生産能力	18万枚	24万枚	28万枚	30万枚	34万枚	40万枚	42万枚
当社グループ シェア	19%	24%	29%	30%	31%	33%	33%

注：RST調べ

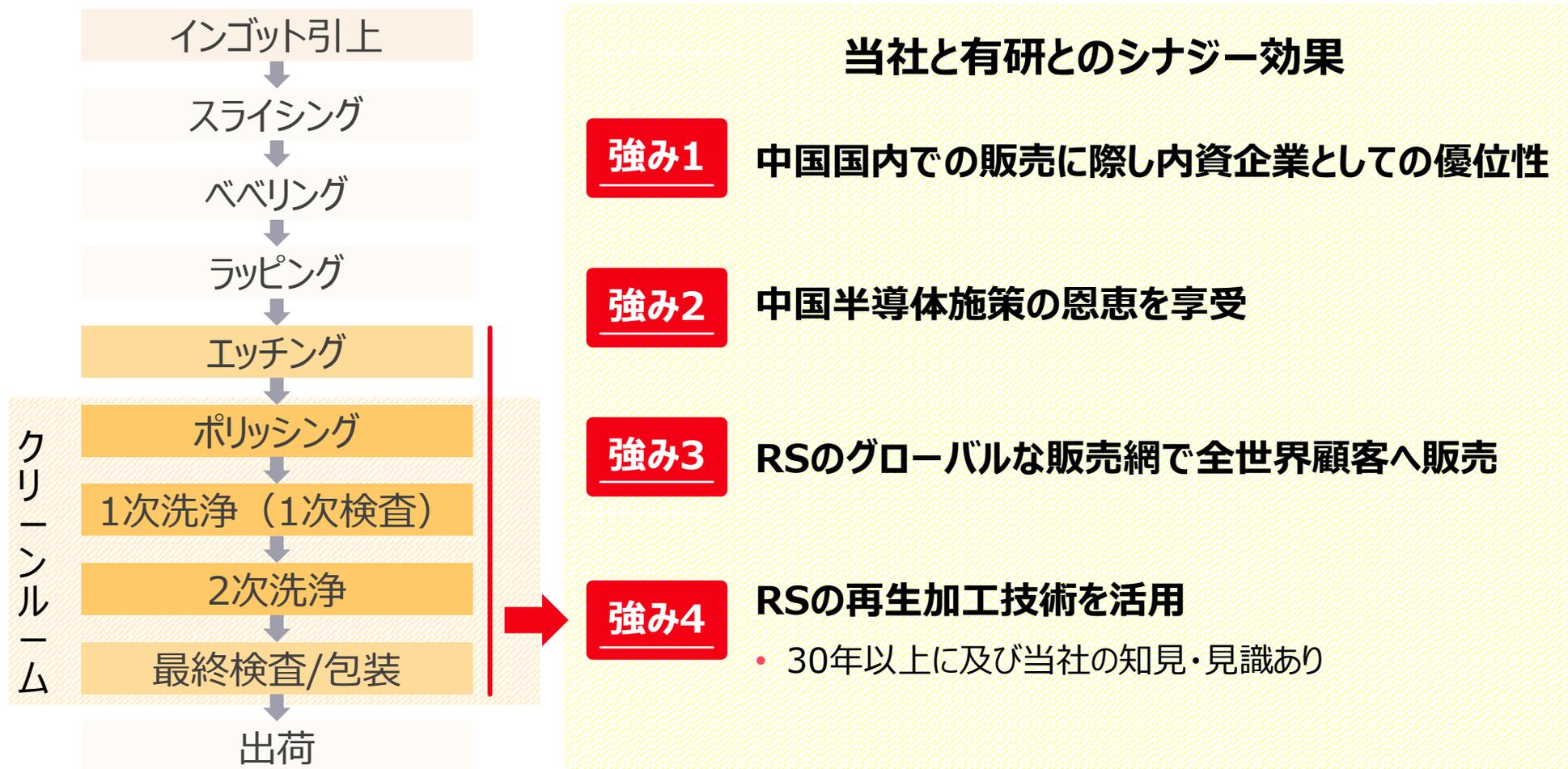
三本木工場と台湾子会社の出荷推移 (2016年-2021年)

三本木工場と台湾子会社の12インチウェーハ出荷枚数推移



プライムウェーハビジネスに進出

- 中国中央政府直属企業の北京有色金属研究総院（現 有研科技集团有限公司）との合併会社を設立。内資企業（中国の国内企業）として半導体事業を推進



中国における当社合併相手について

- 1952年創立。**中国の非鉄金属分野で最大の国有研究機関。**
- 中国の企業数約1,300万社のうち、国有企業は30万社。
その内、中央政府直属企業は88社であり、GRINMはその中の1社。
- 政府・産業・学問が一体化した研究機関で、中央政府の非鉄金属分野における方針は当該会社を通して発信される。
- 研究の成果物として、事業会社を設立。現在、その数は34社にも及ぶ。
- 当社との合併会社である北京有研RS半導体科技有限公司（BGRS）の傘下に入るGRITEKは2001年事業会社第1号として設立された。



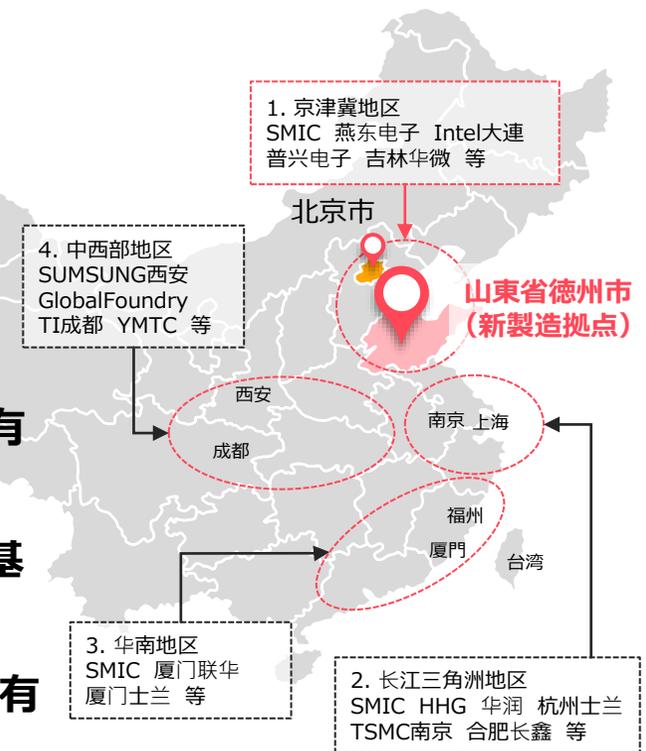
徳州市との提携：背景、経緯及び現状（山東GRITEK新工場竣工）

提携の背景

1. 周辺に世界的な主要半導体メーカーの工場誘致が進み、半導体メーカーの集積地に近い好立地であること（右図参照）
2. 水道光熱費の低減や安価な社宅の提供といった福利厚生面が充実していること
3. 理工系大学が近隣にあり、優秀な人材獲得の面で優位性があること
4. 最大約50万㎡（当初は20万㎡）まで拡張可能な敷地により今後の中国事業推進に十分対応できる用地が確保されていること

経緯及び現状

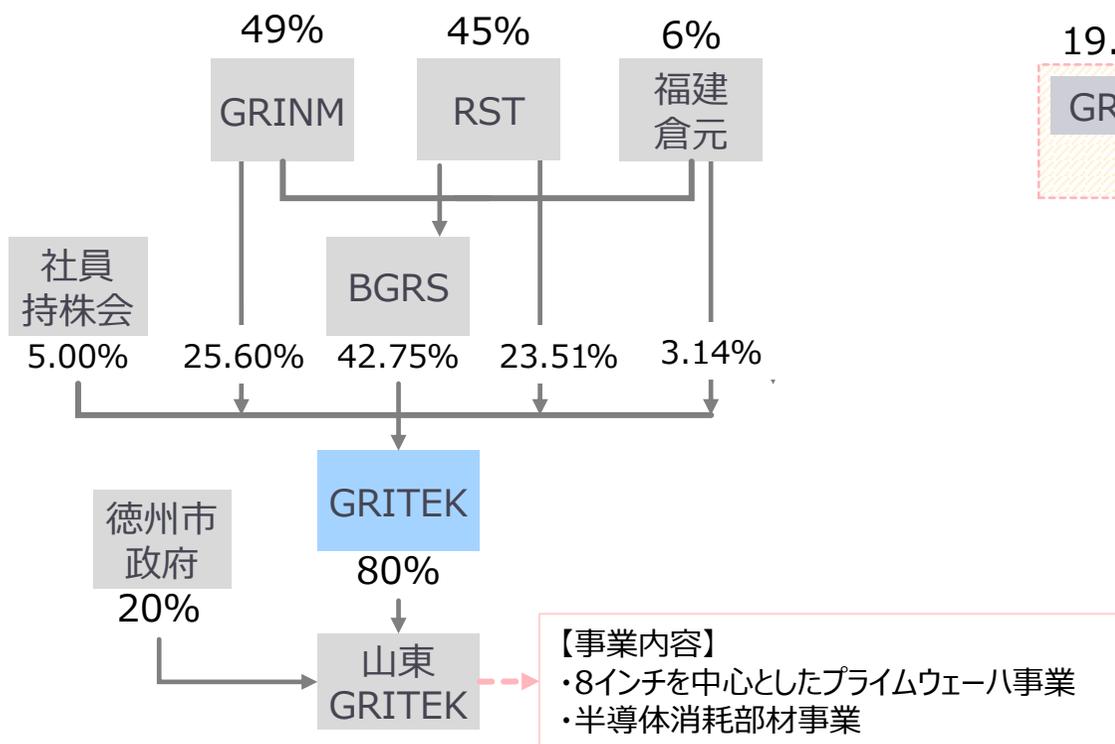
1. 2018年8月23日に8インチウェーハビジネスを手掛ける新会社（山東有研半導体材料有限公司）設立
2. 2019年12月に有研科技集团有限公司、徳州滙達半導体股権投資基金パートナー企業及び山東省徳州市政府と四者間で合併契約を締結
3. 2020年3月に12インチウェーハビジネスを手掛ける新合併会社（山東有研RS半導体材料有限公司）を設立
4. 2020年10月16に徳州市の新工場竣工式を実施



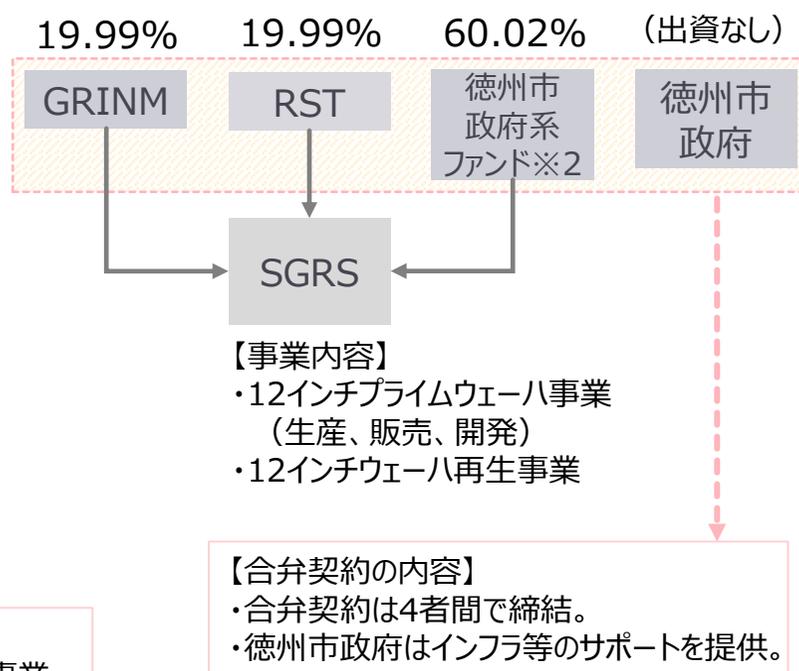
中国事業への出資スキーム（2020年11月開示内容実施後）

- 上場準備の一環として、BGRSが保有するGRITEK株式の一部譲渡（2020年11月開示）の実施を取締役会で決議・実施。
- 上記開示内容実施後の出資形態は以下のとおり。

8インチウェーハ事業 出資形態 ※1



12インチウェーハ事業 出資形態



※1 2020年11月19日付け開示資料「（開示事項の経過）当社海外子会社の上場準備に伴う株式一部譲渡のお知らせ」の開示内容を実施した後の出資形態を示しております。なお、SGRSへの出資比率は最終的な出資比率であり、同社への出資は、出資契約に基づき段階的に実施されます。

※2 德州滙達半導体股権投資基金パートナー企業

業績推移

(百万円)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期
売上高	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561
売上総利益	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681
販管費	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151
営業利益	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530
経常利益	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252
当期利益 ※	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824
配当金 (円)	-	-	-	10	5	10	15	20
設備投資	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	12,409
減価償却 費	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674
研究開発 費	1	6	11	85	183	501	449	929
従業員数 (正社員) (人)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187

※親会社株主に帰属する当期純利益

主要財務諸表

(百万円)	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
資産の部								
流動資産	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626
現金及び預金	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082
受取手形及び売掛金	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321
商品及び製品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116
固定資産	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124
有形固定資産	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146
無形固定資産	19	15	29	23	19	1,099	732	527
投資その他資産	27	130	148	158	149	453	506	1,451
資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750
負債の部								
流動負債	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631
支払手形及び買掛金	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871
有利子負債	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522
固定負債	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754
長期借入金	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613
負債合計	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385
純資産の部								
純資産	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365
負債・純資産合計	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750

*2013年12月期は単独決算となっております

セグメント別 業績推移

(百万円)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期	2020年 12月期
売上高								
ウェーハ再生事業	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461
プライムウェーハ製造販売事業	—	—	—	—	—	11,918	10,058	8,755
半導体生産設備の買収・販売	—	—	—	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272
その他、調整額	127	151	178	66	52	△331	△380	△927
セグメント利益								
ウェーハ再生事業	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027
プライムウェーハ製造販売事業	—	—	—	—	—	2,048	1,503	1,041
半導体生産設備の買収・販売	—	—	—	230	130	366	171	211
その他、調整額	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749
セグメント資産								
ウェーハ再生事業	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698
プライムウェーハ製造販売事業	—	—	—	—	—	21,313	29,311	35,697
半導体生産設備の買収・販売	—	—	—	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387
その他、調整額	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968

*2015年、2016年、2017年12月期の決算数値は2019年3月5日にリリースした訂正後の数値となっております

当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性があります。

本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。